

## SESAM 可饱和吸收镜 (半饱和吸收片 单模光纤跳线 弛豫时间 $\tau$ 18ps) 1030nm



### 产品描述:

BATOP 现已成为用于被动锁模激光器的可饱和吸收体的优秀供应商。可饱和吸收产品集合了各式各样的不同的器件，从可饱和吸收镜(SESAM)，到可饱和输出镜(SOC)和用于透过应用的可饱和吸收体(SA)。迄今为止，可饱和吸收产品已经覆盖了800nm到2.6 $\mu$ m的常用激光波长范围。

可饱和吸收镜是具有 AlAs/GaAs 四分之一波长堆叠的布拉格反射镜，生长在具有一个或多个低温 GaAs (LT-GaAs) 或 LT-InGaAs 薄膜作为可饱和吸收器的 GaAs 晶片上。

我们的载流子弛豫时间在皮秒范围内的可饱和吸收镜可用于二极管泵浦激光器的被动锁模和调Q。可以调整薄膜叠层的设计，以满足皮秒和飞秒区域不同被动锁模激光器的要求。

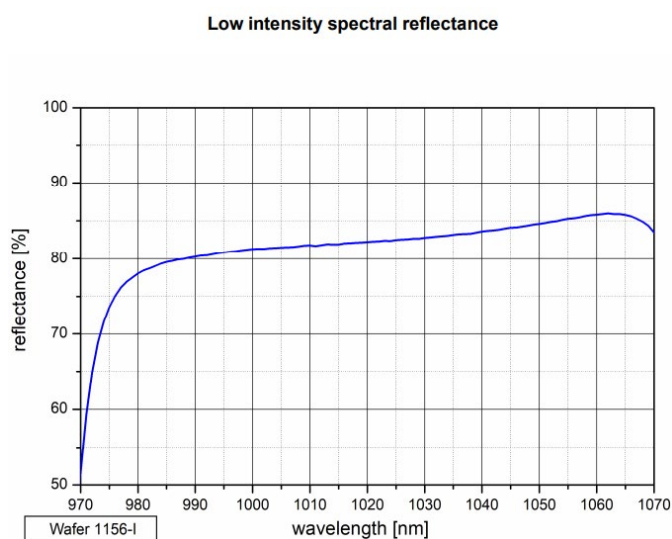
### 型号说明:

- ☀ Laser wavelength  $\lambda = 1030 \text{ nm}$
- ☀ High reflection band ( $R > 50\%$ )  $\lambda = 990 \dots 1060 \text{ nm}$
- ☀ Absorbance 吸收率  $A_0 = 18 \%$
- ☀ Modulation depth  $\Delta R = 14 \%$
- ☀ Non-saturable loss  $A_{ns} = 4 \%$
- ☀ Saturation fluence  $\Phi_{sat} = 26 \mu\text{J}/\text{cm}^2$
- ☀ Relaxation time constant 弛豫时间  $\tau = 18 \text{ ps}$
- ☀ Damage threshold  $\Phi = 2 \text{ mJ}/\text{cm}^2$
- ☀ 切屑面积4.0 mm x 4.0 mm;其他尺寸按要求
- ☀ 切屑厚度450 $\mu$ m
- ☀ 保护SAM受电介质前层安装的保护选项x表示安装类型, 如下所示:

## 封装形式:

- ☀ x = 0 unmounted
- ☀ x = 12.7 g glued on a gold plated Cu-cylinder with 12.7 mm (x = 12.7 g 粘在Φ12.7 mm镀金铜圆柱体上)
- ☀ x = 25.4 g glued on a gold plated Cu-cylinder with 25.4 mm
- ☀ x = 12.7 s soldered on a gold plated Cu-cylinder with 12.7 mm
- ☀ x = 25.4 s soldered on a gold plated Cu-cylinder with 25.4 mm
- ☀ x = FC mounted on a 1 m monomode fiber cable with FC connector (x = FC 安装在带FC连接器的1米单模光缆上)

## 低强度光谱反射率:



## 封装形式:

### 规格型号说明: SAM-λ-A-τ-x

λ=Wavelength 波长

A=Absorptance 吸收率

τ=Relaxation time 弛豫时间

x=Mounting condition 封装形式

### 可选封装形式

x = 4.0-0

x = 1.0b-0

x = 1.3b-0

(散热器)Heat sink FM-1.3 (FM-1.3 - Fiber Mount for SAM chips 1.3 mm x 1.3 mm)

x = 4.0-12.7g-c / 4.0-12.7g-e

x = 4.0-12.7s-c / 4.0-12.7s-e

x = 4.0-25.0g-c / 4.0-25.0g-e

x = 4.0-25.0s-c / 4.0-25.0s-e

x = 4.0-25.4g-c / 4.0-25.4g-e



x = 4.0-25.4s-c / 4.0-25.4s-e

x = 4.0-25.0w-c / 4.0-25.0w-e

x = 4.0-25.0h-c / 4.0-25.0h-e

x = FC/(A)PC-SMF

x = FC/(A)PC-PMF

Passive heat sink PHS (PHS - passive heat sink for fiber coupled SAM 光纤耦合SAM的无源散热器)

如果您选择了**x=4.0-25.4sc**,则安装如下:

芯片尺寸:4毫米

散热器直径:25.4 毫米

安装类型:焊接

位置:中锋

示例: SAM-1040-5-1ps-4.0-25.4sc

激光波长:1040nm

吸收:5%

弛豫时间:1 ps

芯片尺寸:4 毫米 x 4 毫米

焊接在直径为 25.4 毫米的镀金铜散热器的中心

x=FC 封装说明

砷化镓芯片厚度:标准:450μm

正面保护:SAM由电介质正面层保护。

SAM芯片粘在带有FC/PC或FC/APC连接器的单模光纤跳线的一侧。

1,标准电缆长度为1m。

2,可选SAM可安装在特殊光纤上,如保偏熊猫光纤。

3,可选:安装在光纤上的SAM可以连接在无源散热器或带有热电冷却器的有源散热器上。FC/PC连接器端面上的光纤安装SAM-SAM芯片



Fiber mounted SAM



SAM chip on FC/PC connector end face

